

日本企業の対台湾投資動向

台湾・日本（九州）経済交流フォーラム2024

2024年3月12日

みずほ銀行 執行理事
台北・台中・高雄支店 支店長 村田 温

MIZUHO

日系企業の対台湾投資状況

半導体関連、エネルギー、コンシューマーに集中

日本企業の対台湾主要投資事例（2021年以降、經濟部発表）

No	公表日	社名	投資金額	概要
01	21/01/28	(株)日立製作所	15億台湾ドル	現法への増資
02	21/04/28	(株)VITEC ENESTA	8億台湾ドル	現法への増資
03	21/08/25	三井不動産(株)	10億台湾ドル	現法への増資
04	22/01/24	(株)日立製作所	約246.7億台湾ドル	M&A
05	22/09/26	東京海上日動火災保険(株)	約73.8億台湾ドル	現法への増資
06	22/12/26	東京海上日動火災保険(株)	約26.6億台湾ドル	現法への増資
07	23/01/18	ジャパン・リニューアブル・エナジー(株)	2億台湾ドル	現法への増資
08	23/02/24	東京海上日動火災保険(株)	40.1億台湾ドル	現法への増資
09	23/05/30	東京海上日動火災保険(株)	60.21億台湾ドル	現法への増資
10	23/06/27	日東紡績(株)	20億台湾ドル	現法への増資
11	23/09/18	日商REFINE HOLDINGS CO., Ltd.	3億9千台湾ドル	現法への増資

日本企業の台湾投資事例（2022年以降公表資料より集計）

半導体素材・装置が投資の大半を占め、2022年は過去最大の17億USDの投資。

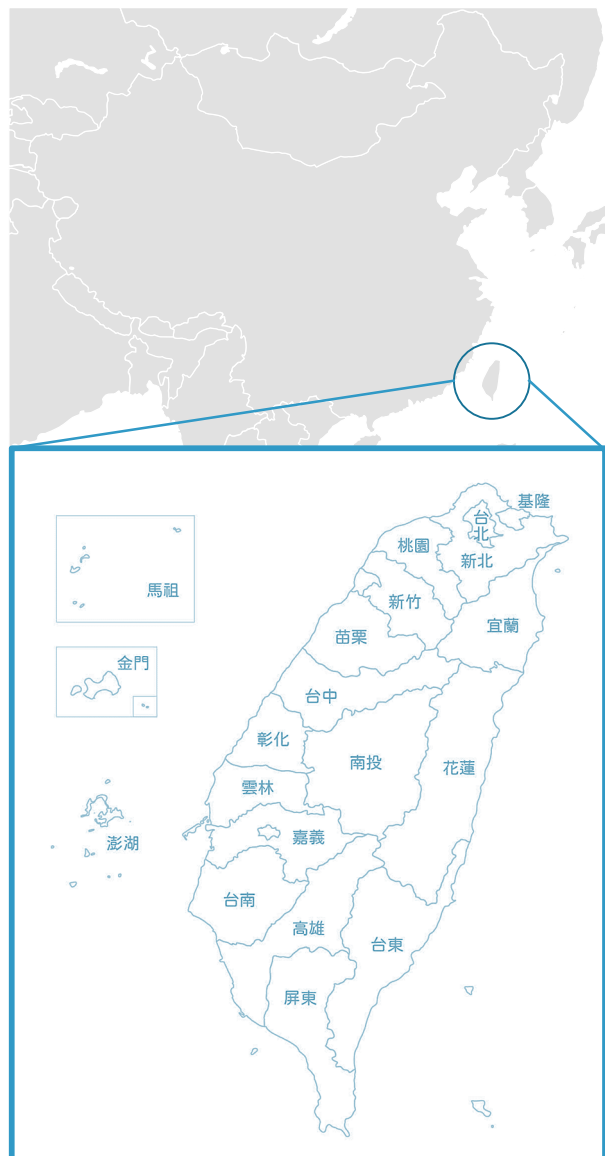
分野	企業	発表年月
半導体	(株)ADEKA	2022/02
	(株)フジインコーポレーテッド	2022/02
	JX金属(株)	2022/02
	(株)RSテクノロジーズ	2022/02
	キオクシア(株)	2022/03
	三菱ガス化学(株)	2022/03
	JSR(株)	2022/03
	(株)トリケミカル研究所	2022/04
	トーカロ(株)	2022/05
	田中貴金属工業(株)	2022/07
	昭和電工マテリアルズ(株)	2022/09
	昭和電工マテリアルズ(株)	2022/09
	セントラル硝子(株)	2022/09
	東京エレクトロン(株)	2022/11
	(株)アドバンテスト	2023/01
	ギガフォトン(株)	2023/01
	エア・ウォーター(株)	2023/02
	JX金属(株)	2023/03
(株)荏原製作所	2023/04	

分野	企業	発表年月
半導体	富士フイルム(株)	2023/05
	AGC(株)	2023/06
	(株)日立ハイテク	2023/06
	新コスモス電機(株)	2023/07
	富士紡ホールディングス(株)	2023/10
	大陽日酸(株)	2023/11

分野	企業	発表年月
エネルギー	サステナブル バッテリー ソリューションズ(株)	2022/03
	東邦ガス(株)、(株)商船三井、北陸電力(株)	2022/03
	(株)商船三井	2022/03
	三井物産	2023/09
コンシューマー	アリナミン製薬(株)	2022/04
	(株)スノーピーク	2022/12
	(株)ロピア	2023/01
	(株)レジデンシャル不動産	2023/03
	(株)肥後銀行	2023/06
	西日本鉄道(株)	2023/08
三起商行(株)	2023/09	

台湾経済の概況

概観：九州より小さい面積に、約2倍の人口。世界21位のGDP、4位の外貨準備高



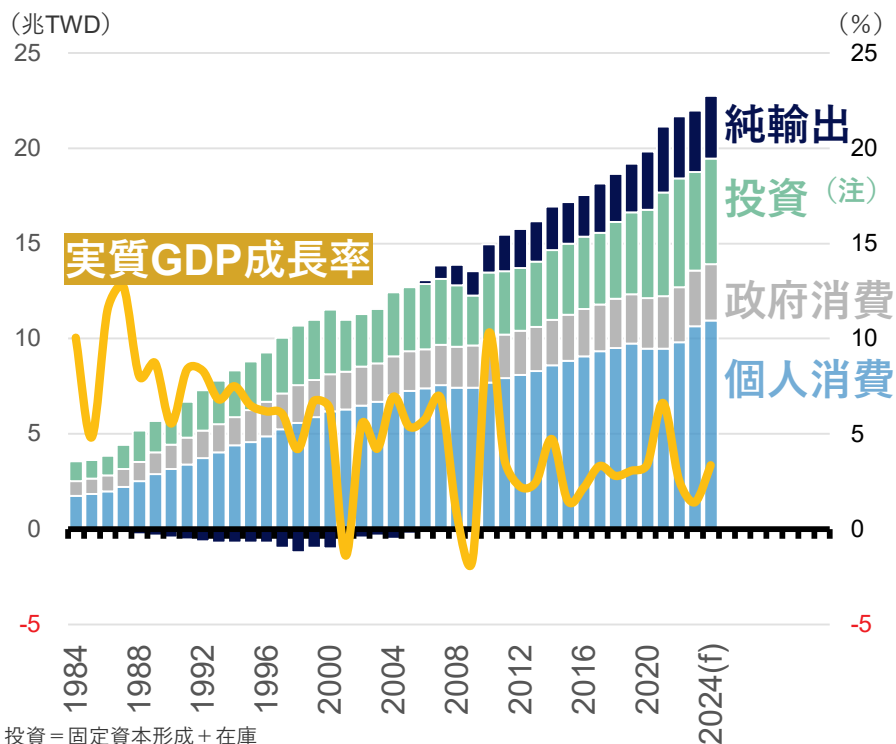
基礎データ

面積	36,197km ² (日本377,974 km ² の約10分の1、九州42,230 km ² よりやや小さい)
人口	2,342 万人 (24年1月)
首都	台北市約 251 万人 (ほか、台中市約285万人、高雄市約274万人) (24年1月)
GDP	名目GDP 7,605 億USD (世界21位、22年) 1人当たり名目GDP 32,687 USD (世界34位、22年)
外貨準備高	5,695 億USD (24年1月) (22年12月時点では、 世界4 位。中国・日本・スイスに次ぐ)
産業構造	<ul style="list-style-type: none">● 名目GDPに占める産業別割合 農業 1.5%、工業 36.8%、サービス業 61.7% (23年)● 工業は半導体製造、サービス業は卸売・小売業や不動産などが中心
日系経済団体数	台北市日本工商会会員： 490 社 (23年3月) 台湾日本人会法人会員： 263 社 (22年12月)
在留邦人数	21,262 人 (24年1月)

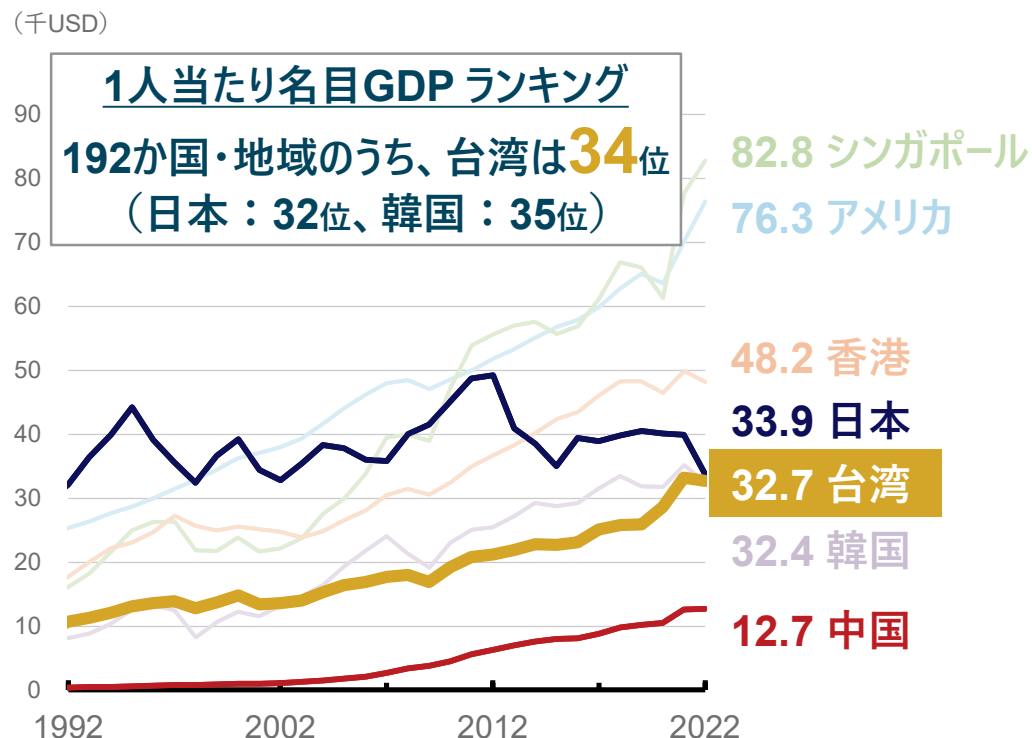
GDP：底堅い個人消費を下支えに、輸出・投資が牽引

- GDPの約半分が**個人消費**。電子部品等の輸出・旺盛な半導体需要に伴う投資がGDPを牽引
- **1人当たりGDP**も年々増加傾向で、**2022年には日本と比肩する32.7千USD**
- **2023年、外食・小売業売上高は過去最高を更新**
半導体、エネルギーを中心とした台湾への投資は引き続き堅調に推移

実質GDP構成要素別推移



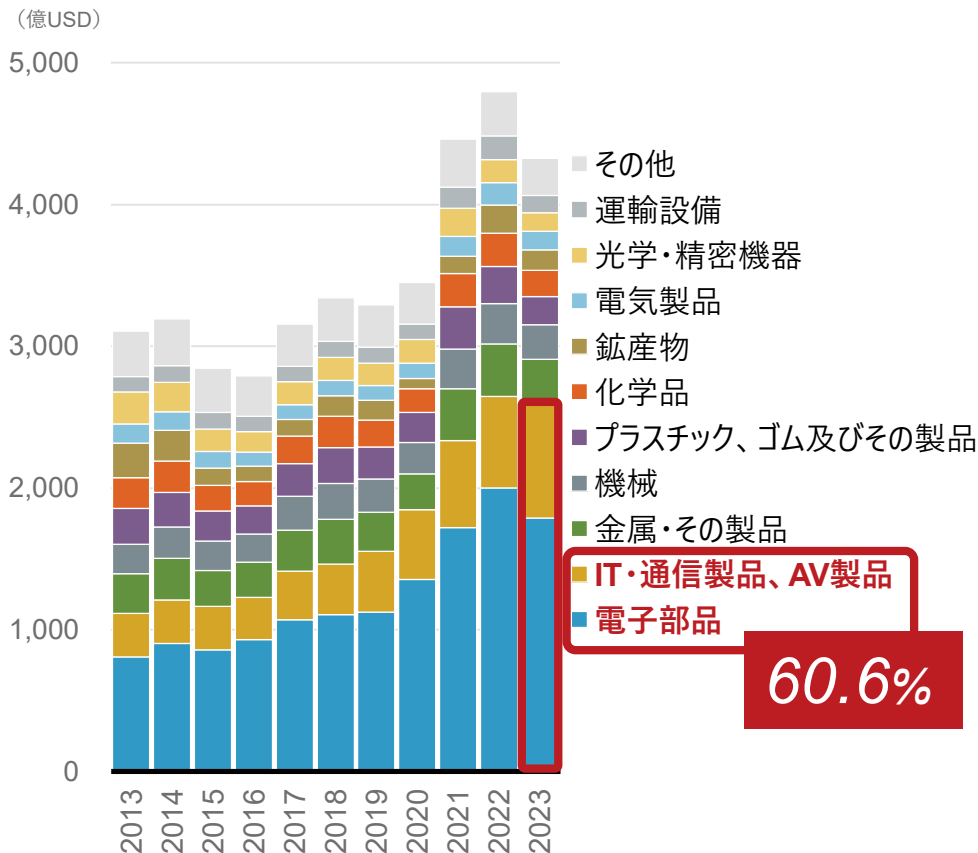
1人当たり名目GDPの推移 (2022年)



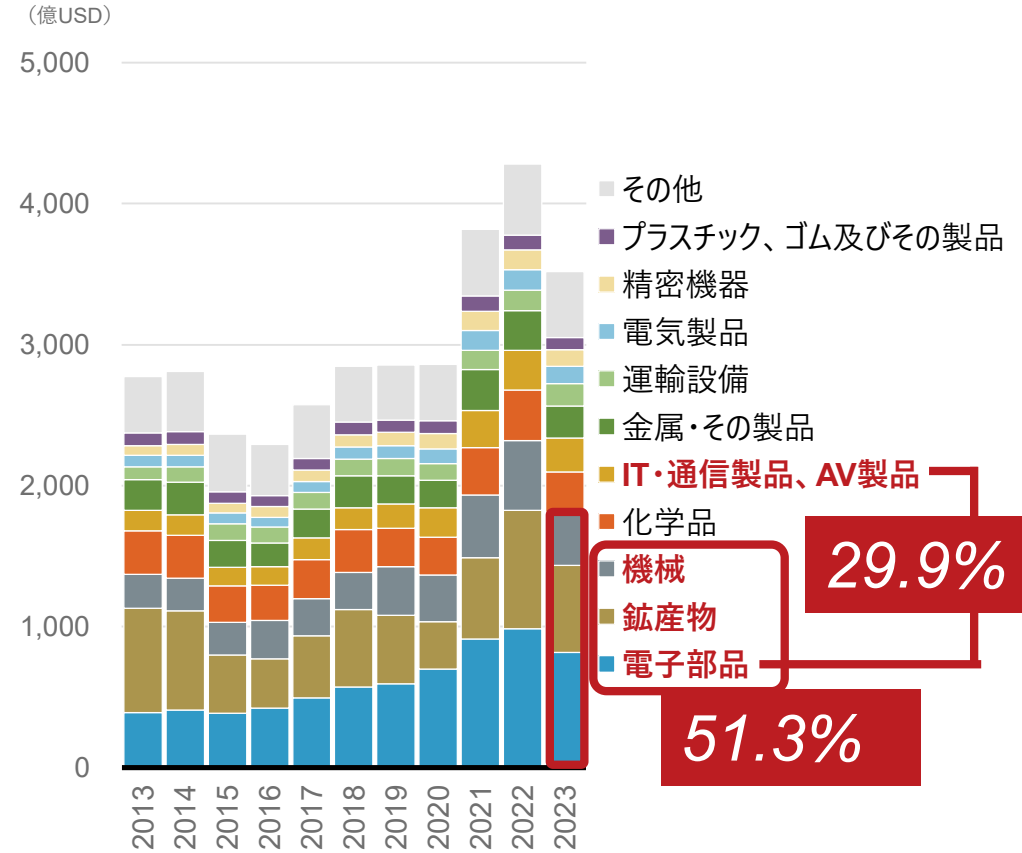
貿易は電機電子等、高付加価値な加工貿易が中心

- 輸出額：「**電子部品**」、「**IT・通信製品、AV製品**」で、**60.6%**
- 輸入額：「**電子部品**」「**鉱産物**」「**機械**」で、**51.3%**
電機電子部品製造のための原材料輸入や、輸出した半導体の完成品輸入と推察

輸出推移（品目別）



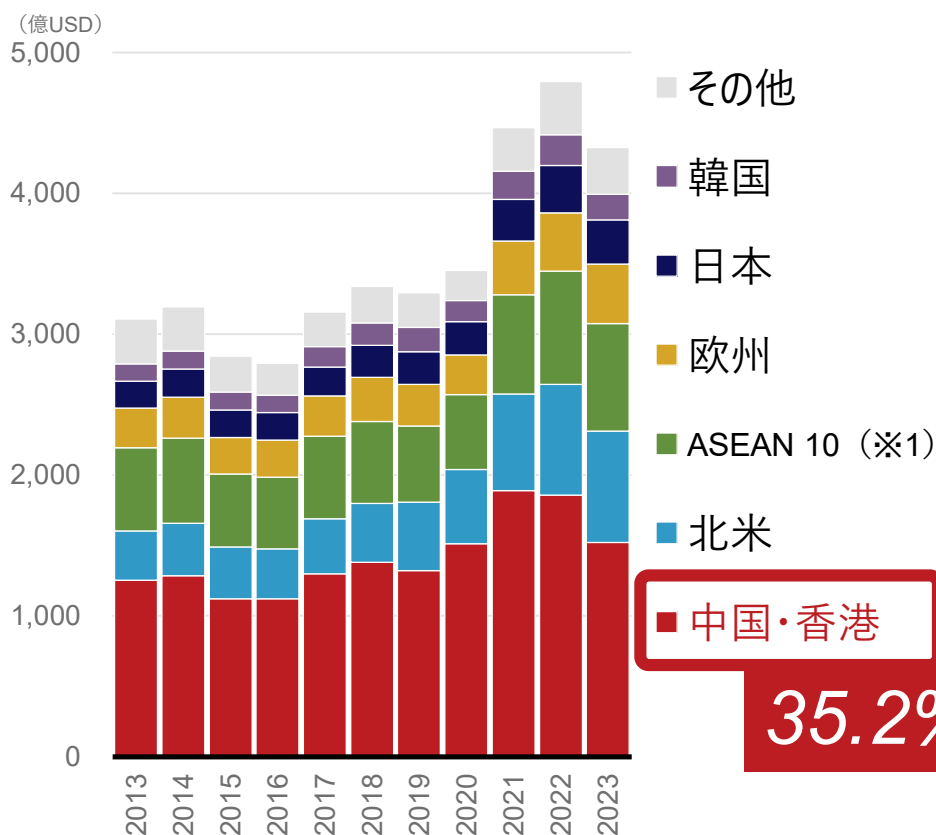
輸入推移（品目別）



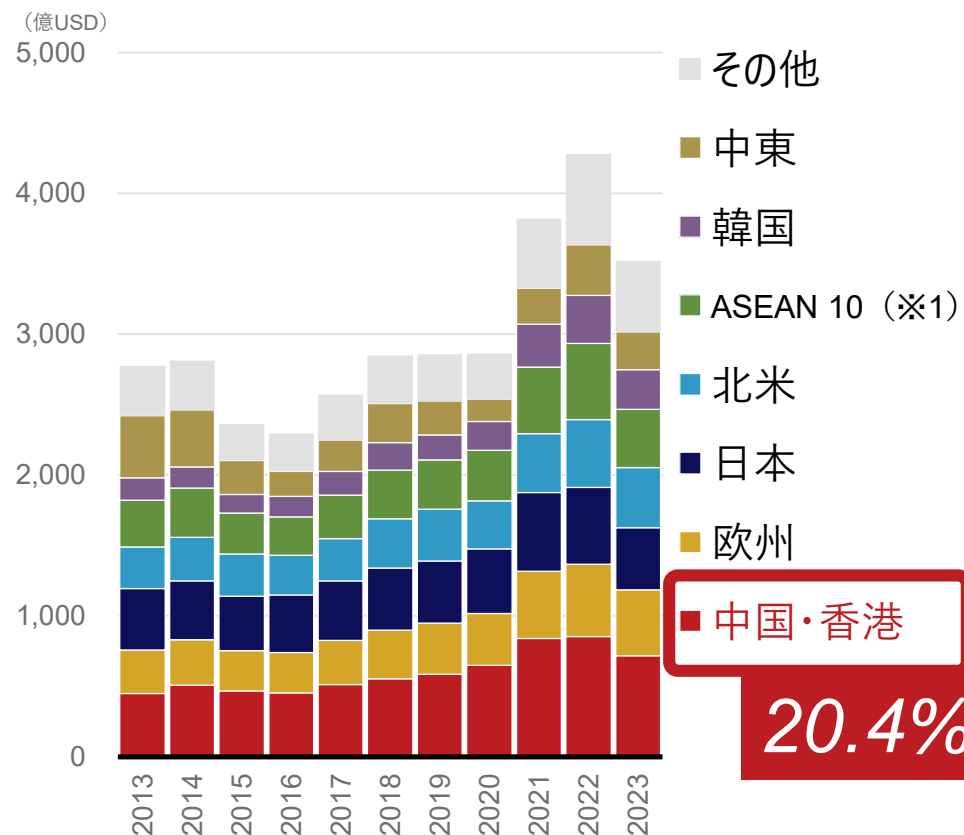
最大の貿易相手国は中国・香港

- 輸出は**2021年に過去最大のUSD1,889億**、**2023年にはUSD1,522億まで減少**。
 主な要因：世界的なサプライチェーンの再編及び中国経済の景気失速による影響（財政部）

輸出推移（地域別）



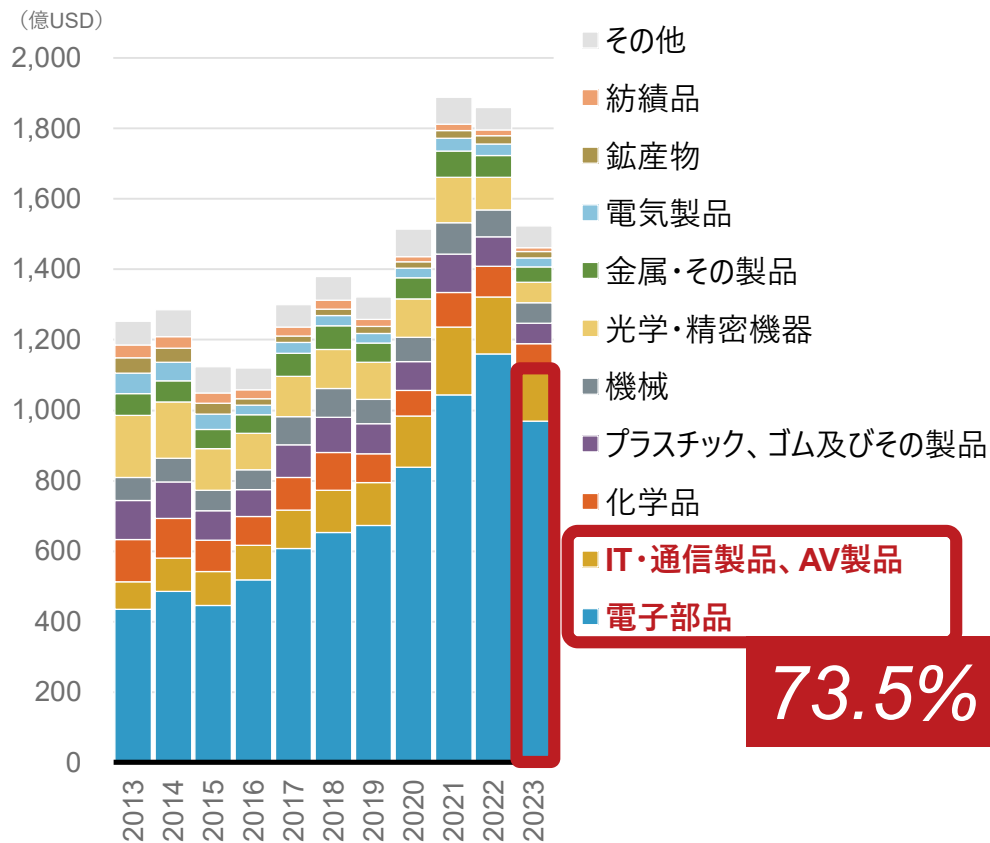
輸入推移（地域別）



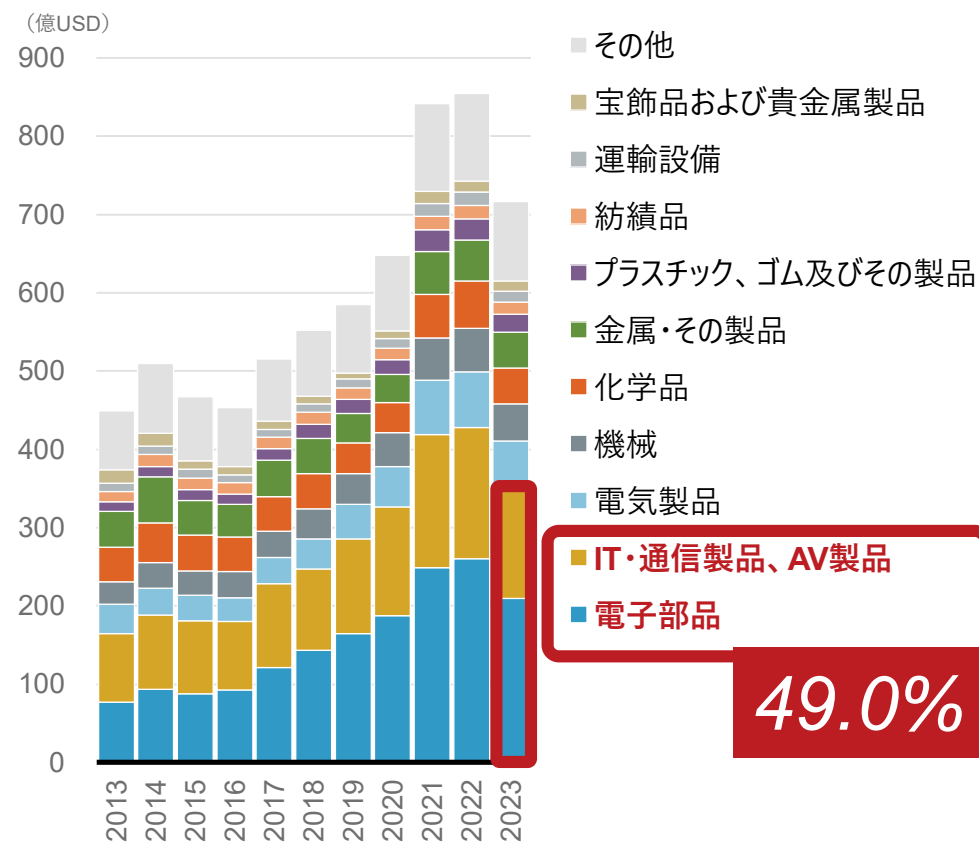
台中貿易関係：台湾は素材・部品の供給、中国は製品組立の位置付け

- 輸出：「**電子部品**」、「**IT・通信製品、AV製品**」で、**73.5%**。半導体ICが大半を占める
- 輸入：「**電子部品**」、「**IT・通信製品、AV製品**」で、**49.0%**。半導体最終製品を輸入

中国への品目別輸出の状況



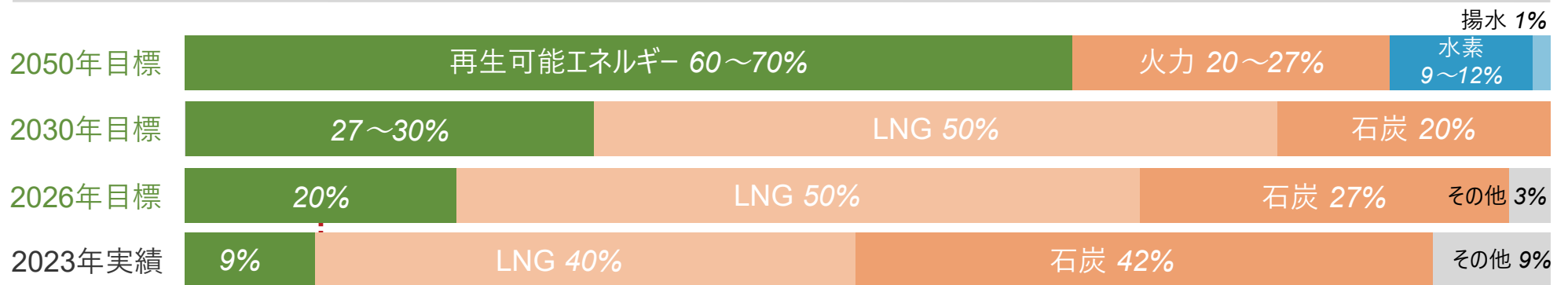
中国からの品目別輸入の状況



2050年までの各段階のエネルギーミックスと再生可能エネルギーの発電目標

- 再エネ 政府目標：2026年10月まで 20%、2030年 27～30%、2050年 60～70%

2023年以降のエネルギーミックス



再生可能エネルギー設置容量目標（2025年）

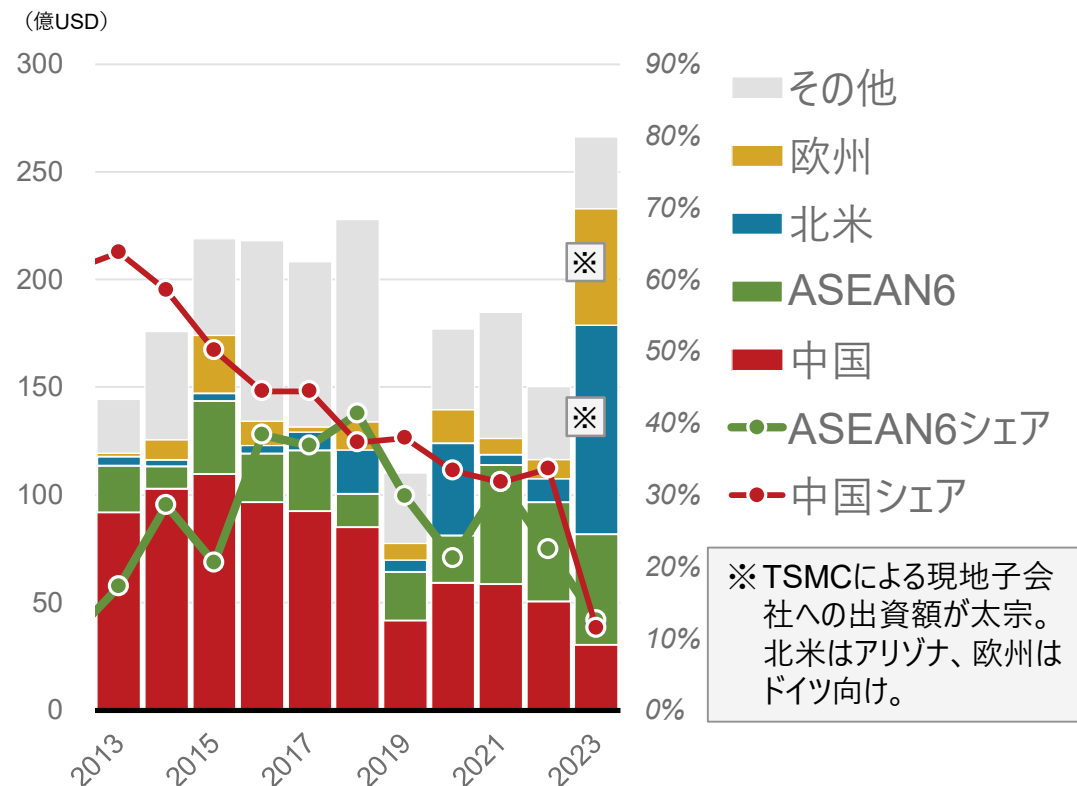


台湾企業・日本企業の投資動向

台湾企業の対外直接投資は、中国一極集中から多極的進出へ

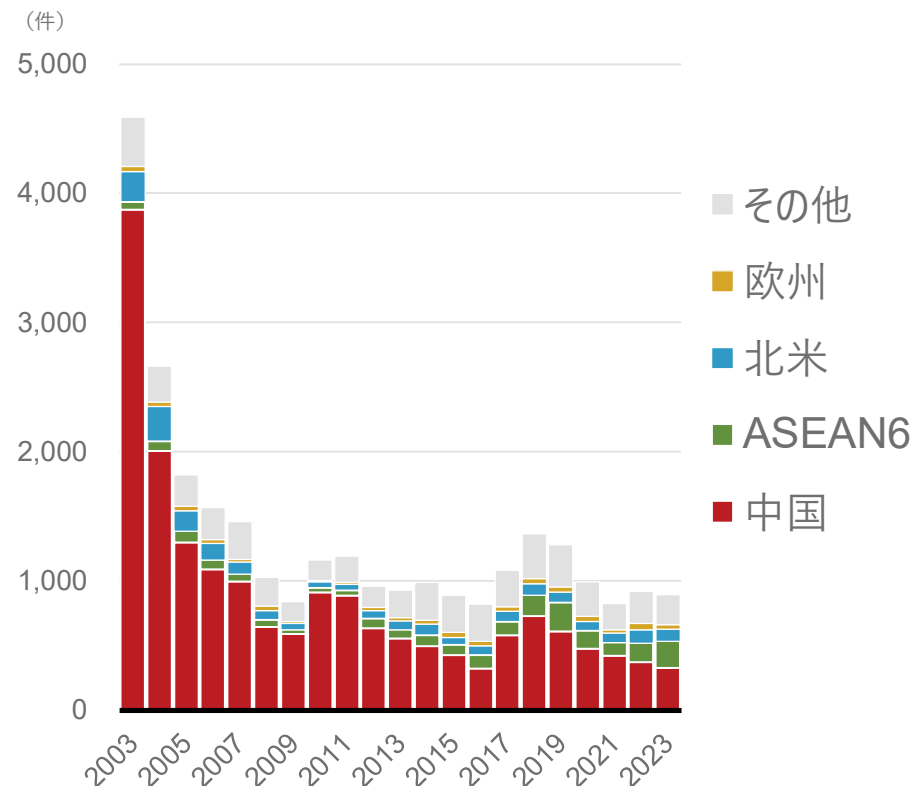
- 中国向け投資は**金額、件数ともに減少傾向**
- 2023年にASEAN6（注）への投資金額が、中国への投資金額を上回った。
 要因：①投資コストの増大、②中国経済失速、③サプライチェーン再編、④地政学的リスク、等

地域別対外直接投資推移（金額）



(注) Asean6は、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム

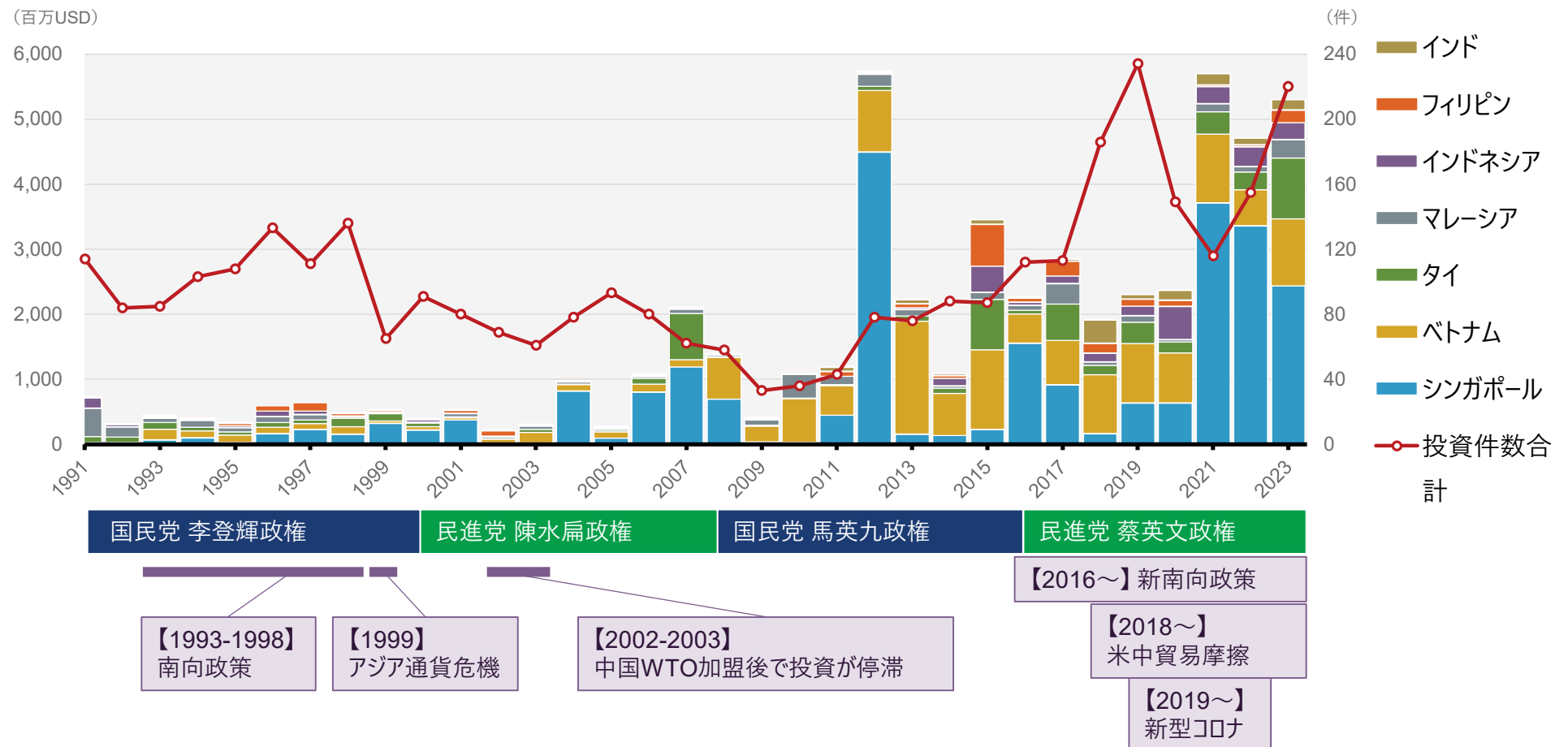
地域別対外直接投資推移（件数）



台湾企業の東南アジア進出加速、近年はベトナム及びシンガポールに集中

- ベトナム：従来化学、紡織などが中心。19年以降、**エレクトロニクス分野への投資が増加**
- シンガポール：**持株会社等の統括会社設立**や**金融・保険関連**の投資が目立つ

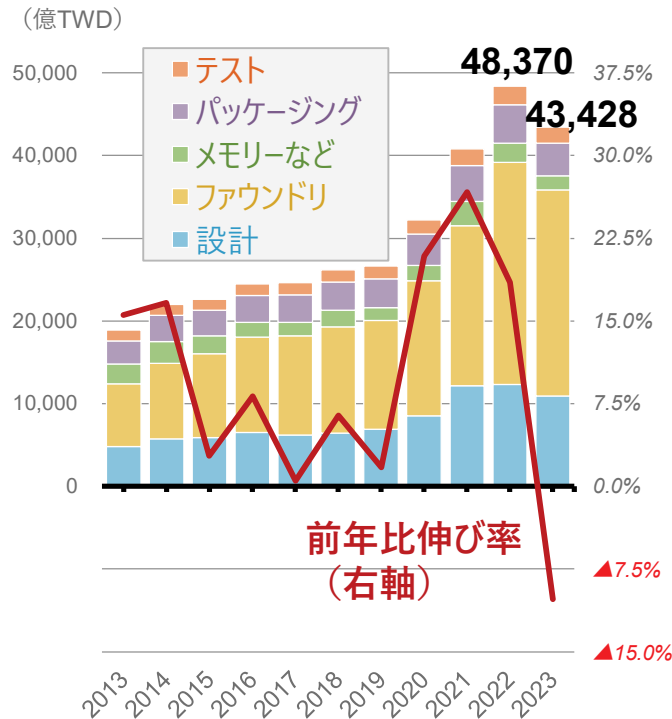
東南アジア主要国向け直接投資推移



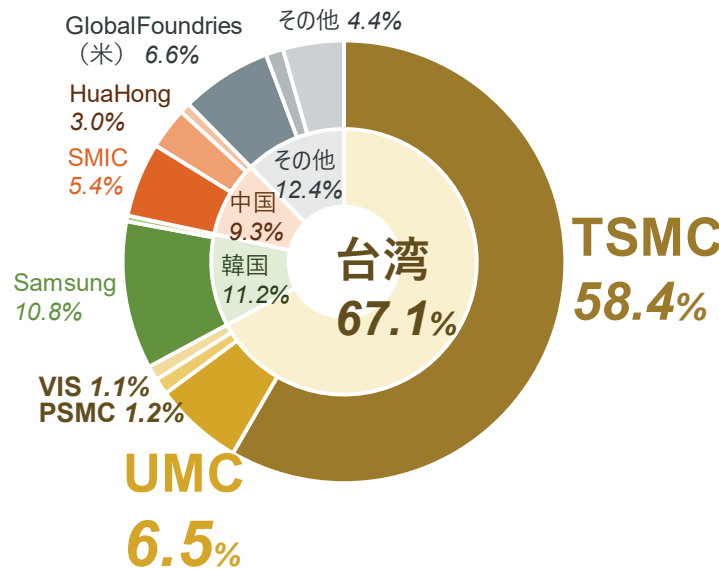
台湾の半導体産業①：市場は成長基調で、台湾は半導体製造の中心

- IC売上高：**2022年、TWD4兆8,370億と過去最高**。2023年は、前年比▲10.2%も、過去2番目
- TSMCは世界シェアで、**58.4%**
- 半導体ビッグ3のうち、TSMCの設備投資額は300億USD超で、Intelを凌駕、Samsungに迫る規模（ファウンドリに限定すれば、**TSMCの投資金額は最大規模**と推察）

台湾のIC売上高推移

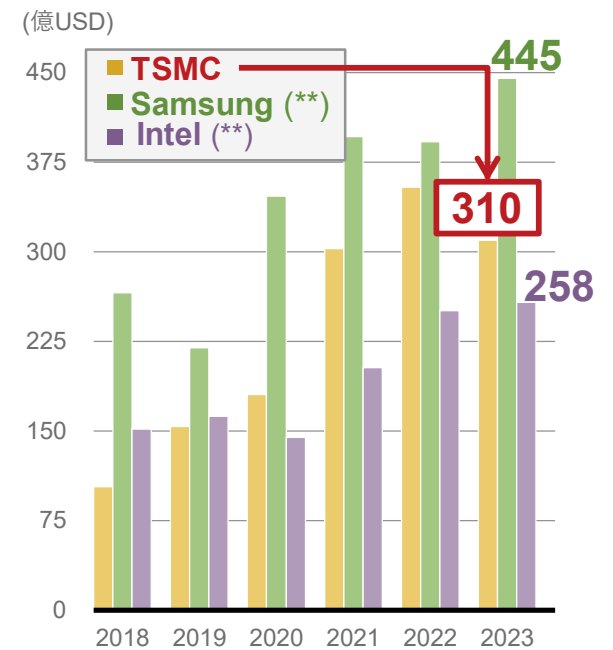


世界ファウンドリ市場シェア (2023年1-6月)



(注) 元データの制約によりDB HiTekは1-3月の数値

BIG3の設備投資額(*) (連結ベース)



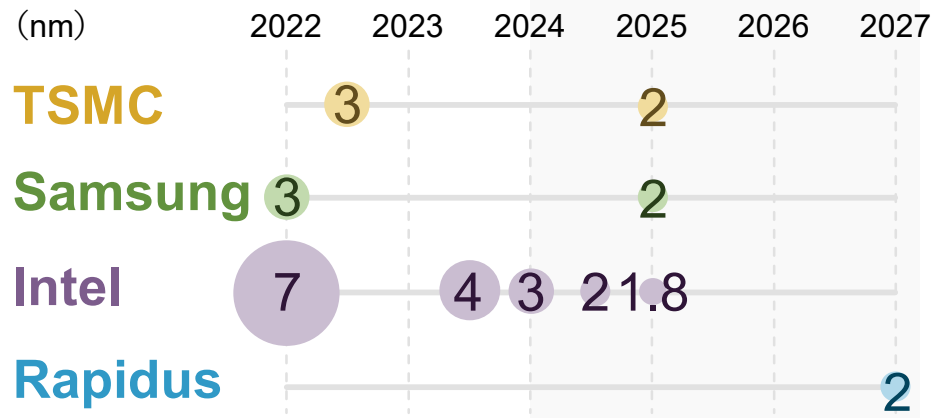
(*) Refinitivによる

(**) SamsungおよびIntelはファウンドリ事業以外に係る設備投資額も含む

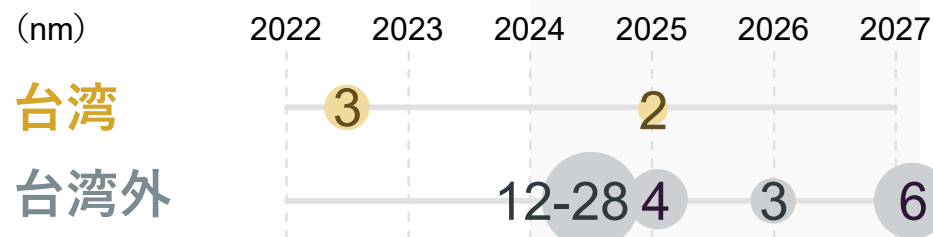
台湾の半導体産業②：先端技術でも規模でも、TSMCの製造の中心は今後も台湾

- 先端半導体開発・量産化、TSMCは業界をリード。**2nmは2025年に台湾で量産開始を目指す**
- **TSMCの生産能力の約9割は台湾**。今後世界各地で工場新設しても、**生産能力の大部分が台湾に有る状況は変わらない**

各社の先端ロジックICの量産開始時期



TSMCの先端ロジックICの量産開始時期



TSMCの既存工場と新設工場の台湾内外比較

(1) 既存工場：月間生産能力：125万枚以上 (2022年)

台湾内	生産能力：全体の約9割	新設計画を含めても、台湾外の実生産能力は月間約32万枚
台湾外	生産能力：全体の約1割	

(2) 新設工場 (台湾内)

所在地	製品	月間生産能力	量産開始予定
新竹	(建設中) 2nm	n.a.	当社全体で、2ナノについて2025年の量産開始を目指す
台中	(計画) n.a.	n.a.	
高雄	(建設中) 2nm	n.a.	

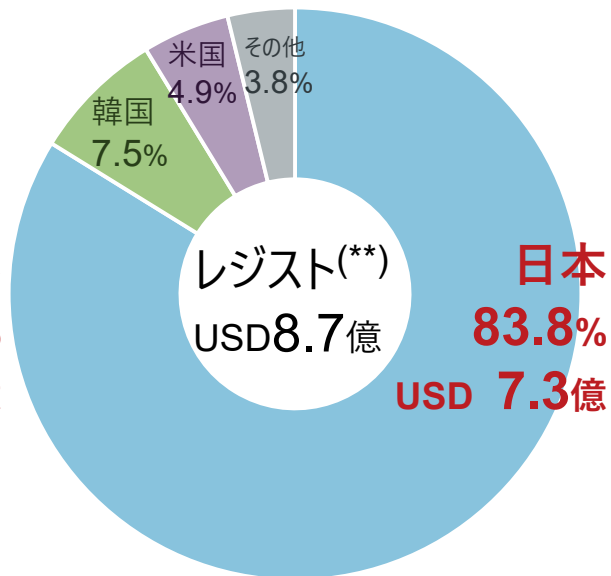
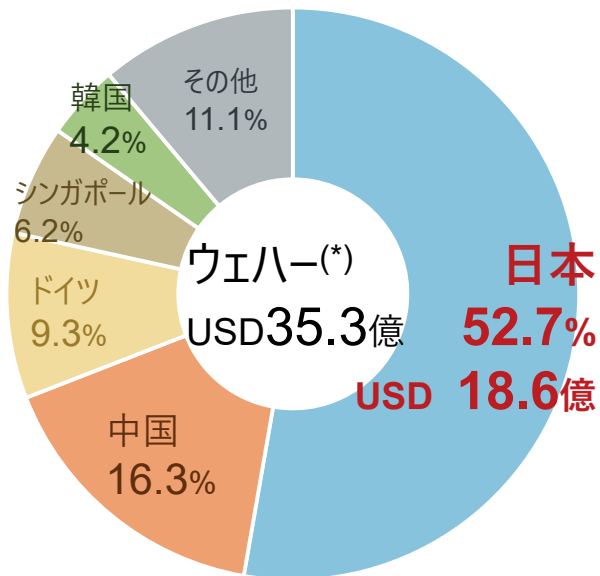
(3) 新設工場 (台湾外)

所在地	製品	月間生産能力	量産開始予定
米・アリゾナ州	(建設中) 3、4nm	5万枚以上	2024年4nm 2026年3nm
日・熊本 [第1]	(建設中) 12、16、22、28nm	[第1+第2] 10万枚以上	2024年末
[第2]	(計画) 6、7nm等		2027年末
独・ザクセン州	(計画) 12、16、22、28nm	約4万	2027年末

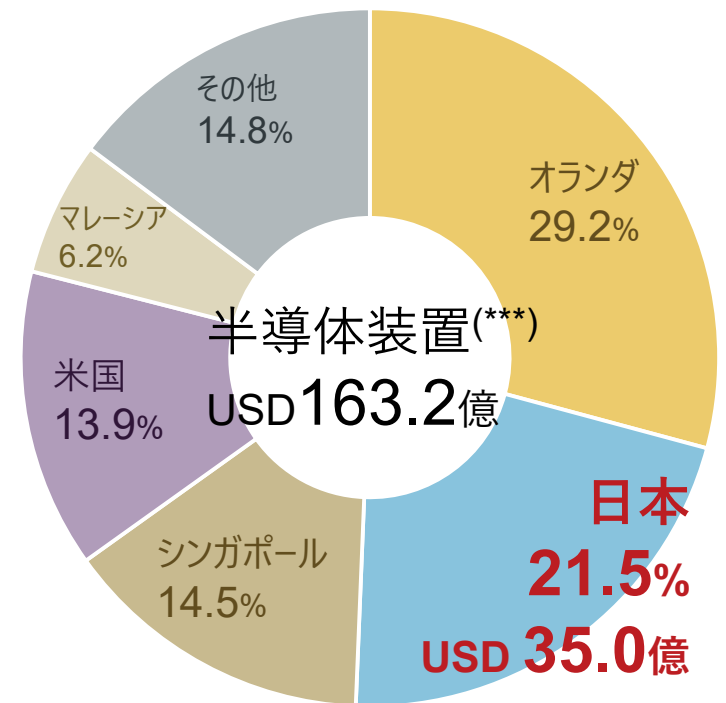
半導体を取り巻く対日貿易関係 – 素材や装置の輸入先として日本は大きな存在

- 台湾にとって、半導体の輸出先あるいは輸入先として**日本は3位**
- 日本は、半導体の素材・装置の輸入先**として大きな存在感

台湾の半導体素材輸入先 (2023年※)



台湾の半導体装置輸入先 (2023年※)



(※) 1-11月(確報値)と12月(速報値)の合計

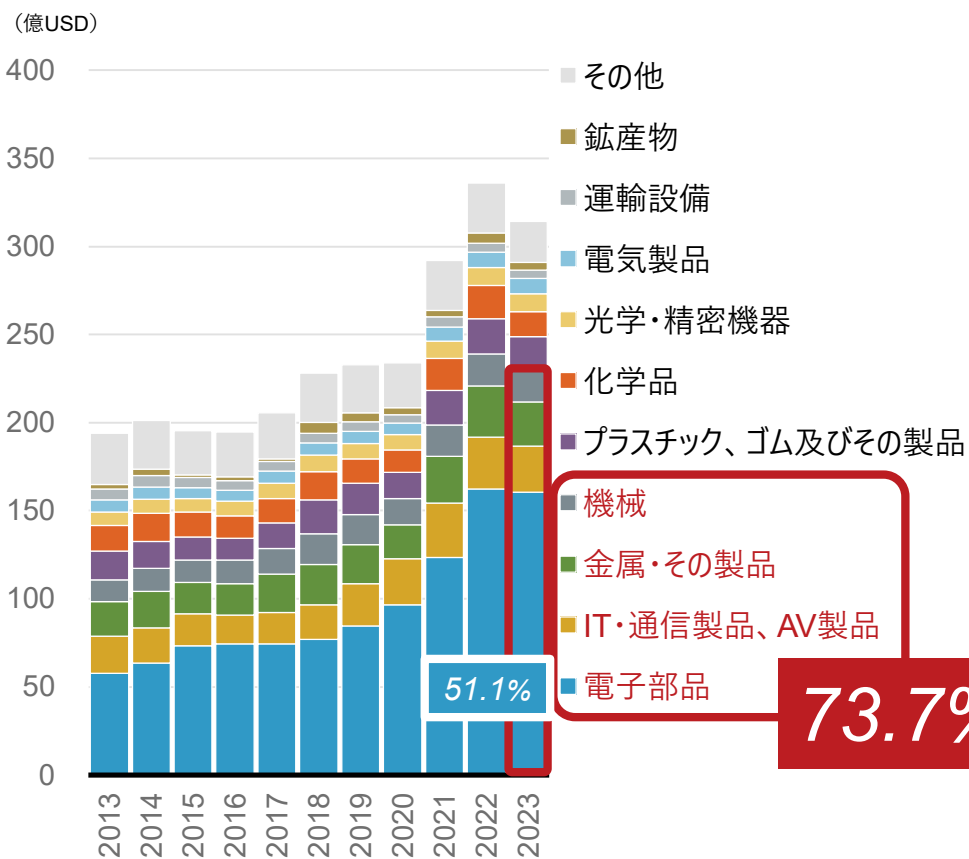
(*) HSコード381800 (**) 同370790

(***) HSコード848610、848620、848640、903082、903141、903180の合計

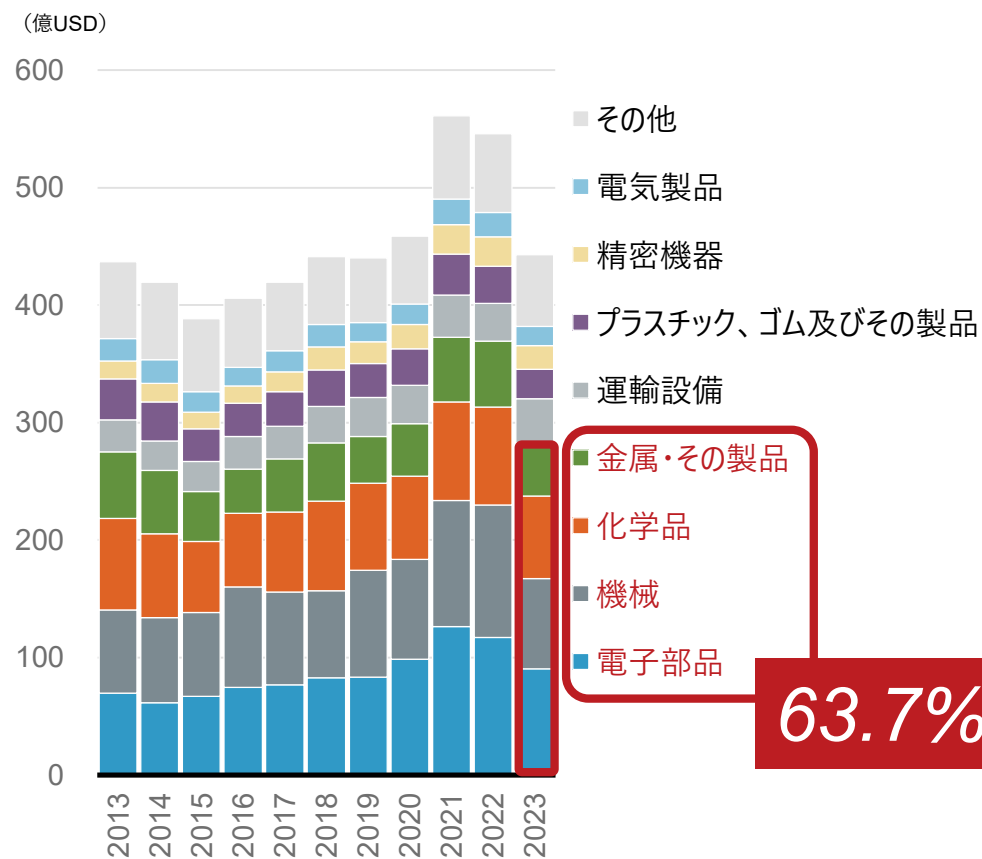
日台貿易関係

- 輸出：「電子部品」、「IT・通信製品、AV製品」、「金属・その製品」、「機械」で、**73.7%**
- 輸入：「電子部品」、「機械」、「化学品」、「金属・その製品」で、**63.7%**
半導体製造装置、素材等の原材料輸入が輸入の大半を占めている

日本への輸出推移（品目別）



日本からの輸入推移（品目別）



日台貿易の世界における位置付け

- 日本は台湾の貿易相手国・地域として3位、台湾は日本の貿易相手国・地域として4位
- 日本企業の海外事業拡大を図る国・地域として、台湾は2023年に8位。
地政学的観点から過去対比で回答率は落ちるが、台湾は引き続き重要地域と認識されている

台湾の貿易総額上位5か国の推移 () は総額に対する構成比

	1位	2位	3位	4位
2021	中国+香港 (33.0%)	米国 (12.7%)	日本 (10.3%)	韓国 (6.1%)
2022	中国+香港 (29.9%)	米国 (13.3%)	日本 (9.7%)	韓国 (6.2%)
2023	中国+香港 (28.6%)	米国 (14.9%)	日本 (9.7%)	韓国 (5.9%)

日本の貿易総額上位5か国の推移 () は総額に対する構成比

	1位	2位	3位	4位
2021	中国+香港 (25.2%)	米国 (14.1%)	台湾 (5.8%)	韓国 (5.5%)
2022	中国+香港 (22.3%)	米国 (13.9%)	オーストラリア (6.4%)	台湾 (5.5%)

日本企業が海外で事業拡大を図る上位10か国・地域 () はアンケートの複数回答での割合

	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位
2021	米国 (49.0%)	ベトナム (46.0%)	中国 (45.9%)	タイ (38.4%)	西欧 (34.9%)	台湾 (32.3%)	シンガポール (26.8%)	インドネシア (25.8%)
2022	米国 (29.6%)	ベトナム (26.5%)	中国 (26.4%)	EU (20.7%)	タイ (18.0%)	インドネシア (13.3%)	インド (12.7%)	台湾 (12.3%)
2023	米国 (28.1%)	ベトナム (24.9%)	中国 (22.6%)	EU (18.6%)	タイ (17.5%)	インド (16.2%)	インドネシア (13.9%)	台湾 (13.6%)

日本の対台湾投資（1/2）

- 台湾への投資金額・件数の国別・地域別順位では、日本は上位で推移
- 投資件数では、卸売業・小売業が34%のシェア

台湾への投資金額の国別・地域別順位

	1位	2位	3位	4位
2021	英国海外領土 (27.3%)	オランダ (10.0%)	日本 (9.8%)	米国 (9.4%)
2022	デンマーク (26.9%)	英国海外領土 (18.8%)	日本 (12.8%)	オーストラリア (8.6%)
2023	シンガポール (26.9%)	ドイツ (13.8%)	英国海外領土 (10.9%)	カナダ (9.6%)

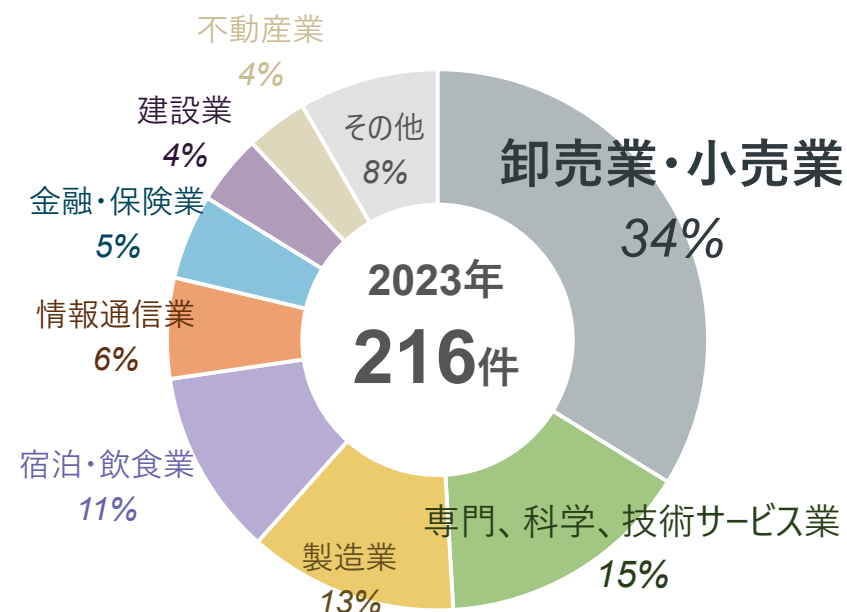
() は投資総額に対する構成比 ※ 2023年 日本は第8位

台湾への投資件数の国別・地域別順位

	1位	2位	3位	4位
2021	香港 (25.3%)	米国 (9.3%)	英国海外領土 (8.6%)	日本 (8.5%)
2022	香港 (28.9%)	英国海外領土 (9.4%)	米国 (9.3%)	日本 (8.5%)
2023	香港 (17.1%)	米国 (11.5%)	日本 (9.4%)	シンガポール (9.0%)

() は投資件数に対する構成比

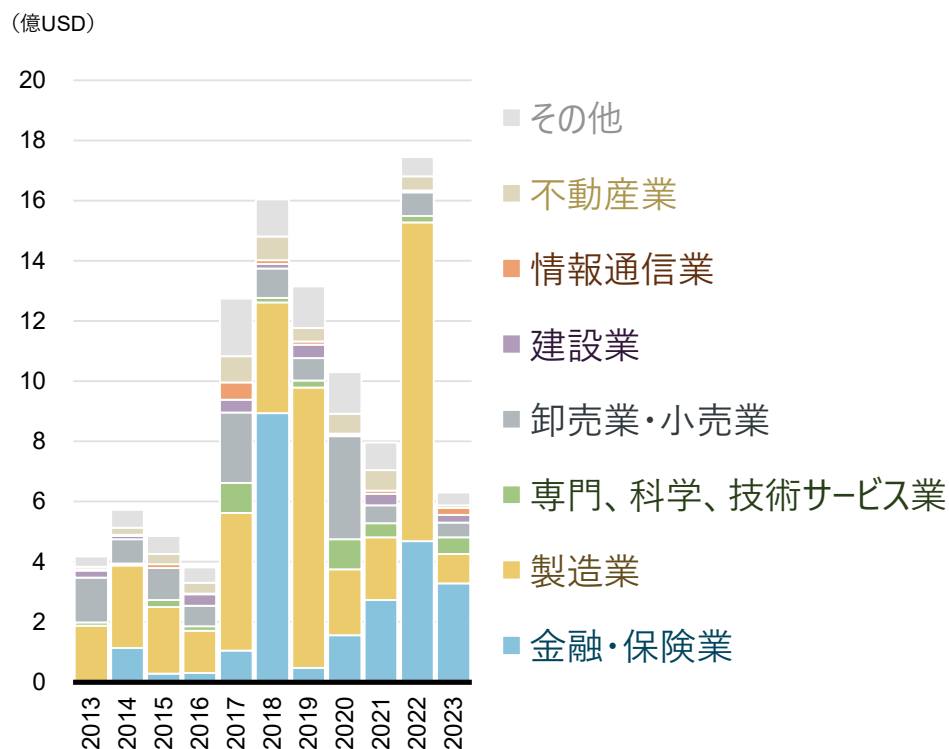
2023年の業種別投資件数割合



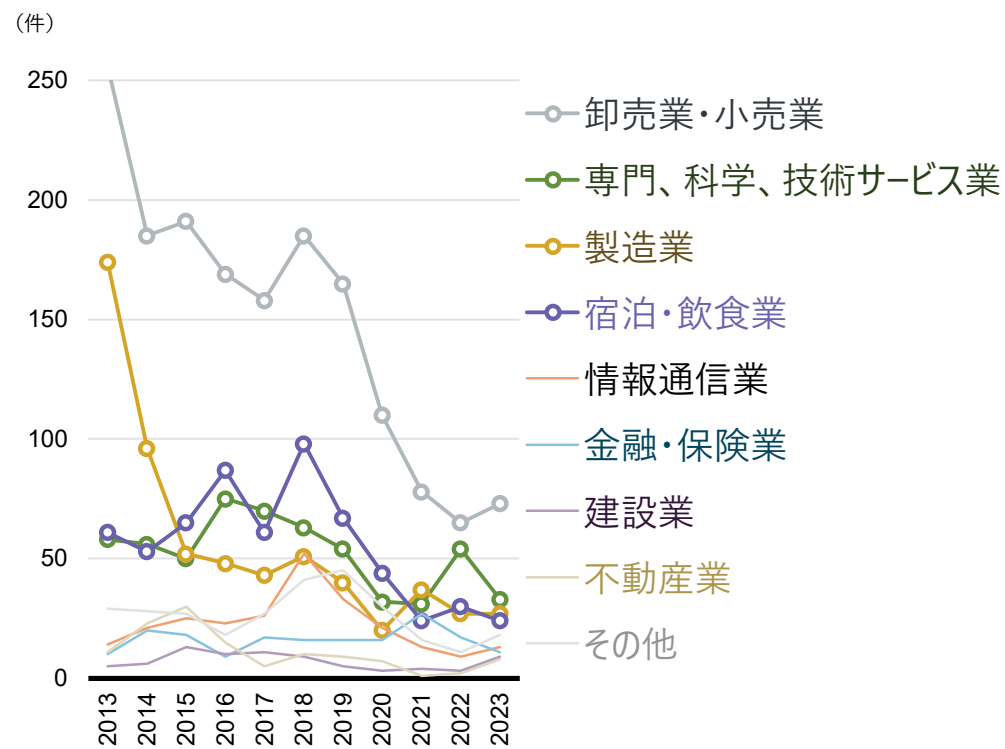
日本の対台湾投資（2/2）

- 金額別：「金融・保険業」、「製造業」、「専門、科学、技術サービス業」の割合が高い
- 件数別：「卸売業・小売業」、「専門、科学、技術サービス業」、「製造業」の割合が高い

業種別対台湾投資推移（金額）



業種別対台湾投資推移（件数）



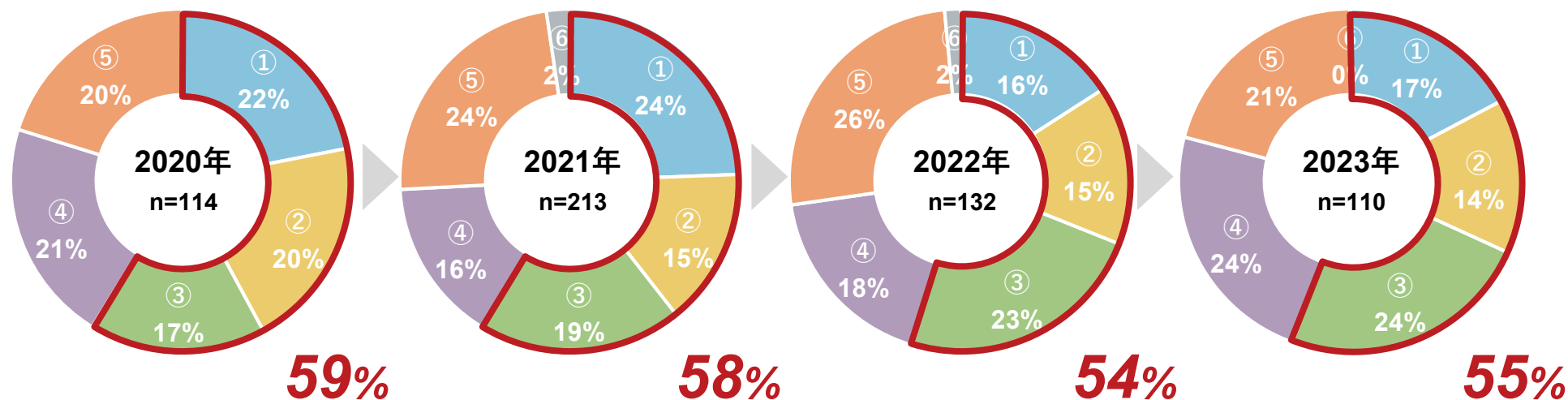
取引先アンケート結果

台湾における今後の事業展開

nは回答総数を指す。以下同じ。

2023年11月22日（水）実施「台日投資カンファレンス（半導体・EV）」アンケート結果

- 回答者の約**50%強**が投資を実行あるいは投資の検討を実施
- 過去2年では、「投資の可否を検討している」の割合が高くなっており、台湾への投資について前向きに検討している企業が増えていると推察

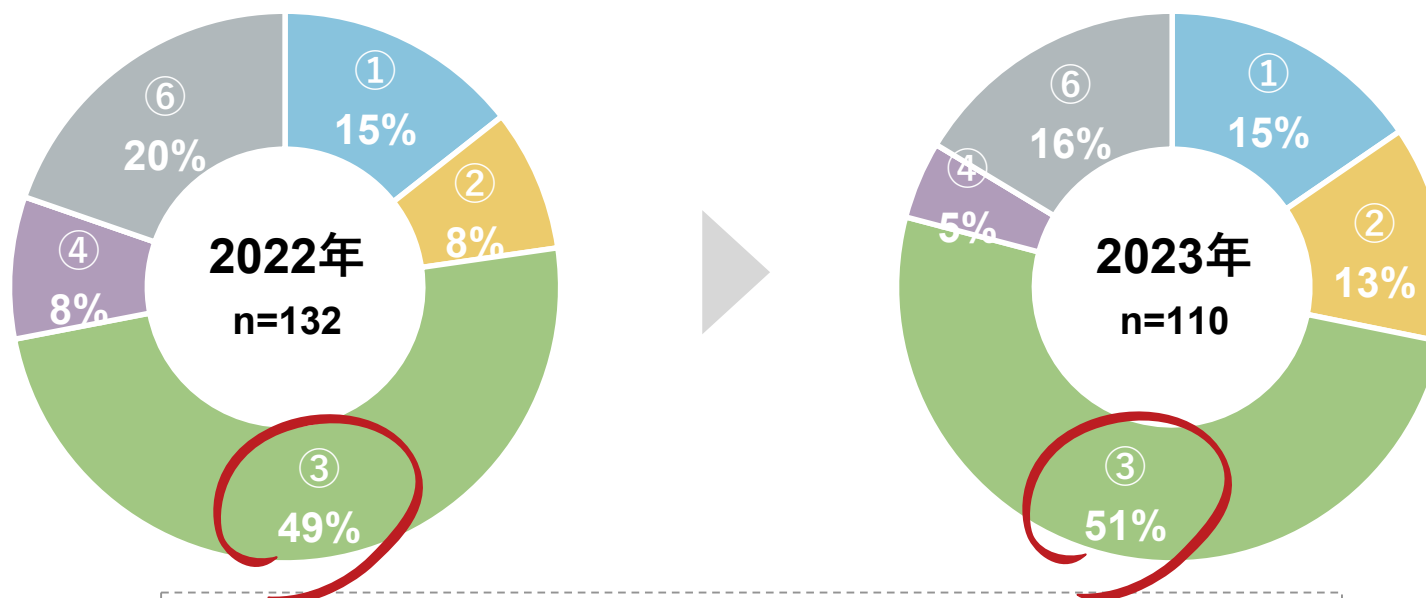


- ① 最近、投資を実行した
- ② 投資の計画を進めている
- ③ 投資の可否を検討している
- ④ 投資の必要性は感じているが、検討はしていない
- ⑤ 投資の可能性はない
- ⑥ ビジネス縮小傾向にあり、事業の効率化を優先

台湾における投資意欲（昨年対比）

2023年11月22日（水）実施「台日投資カンファレンス（半導体・EV）」アンケート結果

- 投資意欲につき半数は大きな変化はないとの回答
- 「投資検討は中止した」との回答は過去2回で0件であることから、投資に慎重になっている回答者は10%未満のみで、多くの企業は投資に後ろ向きな姿勢ではないと読み取れる

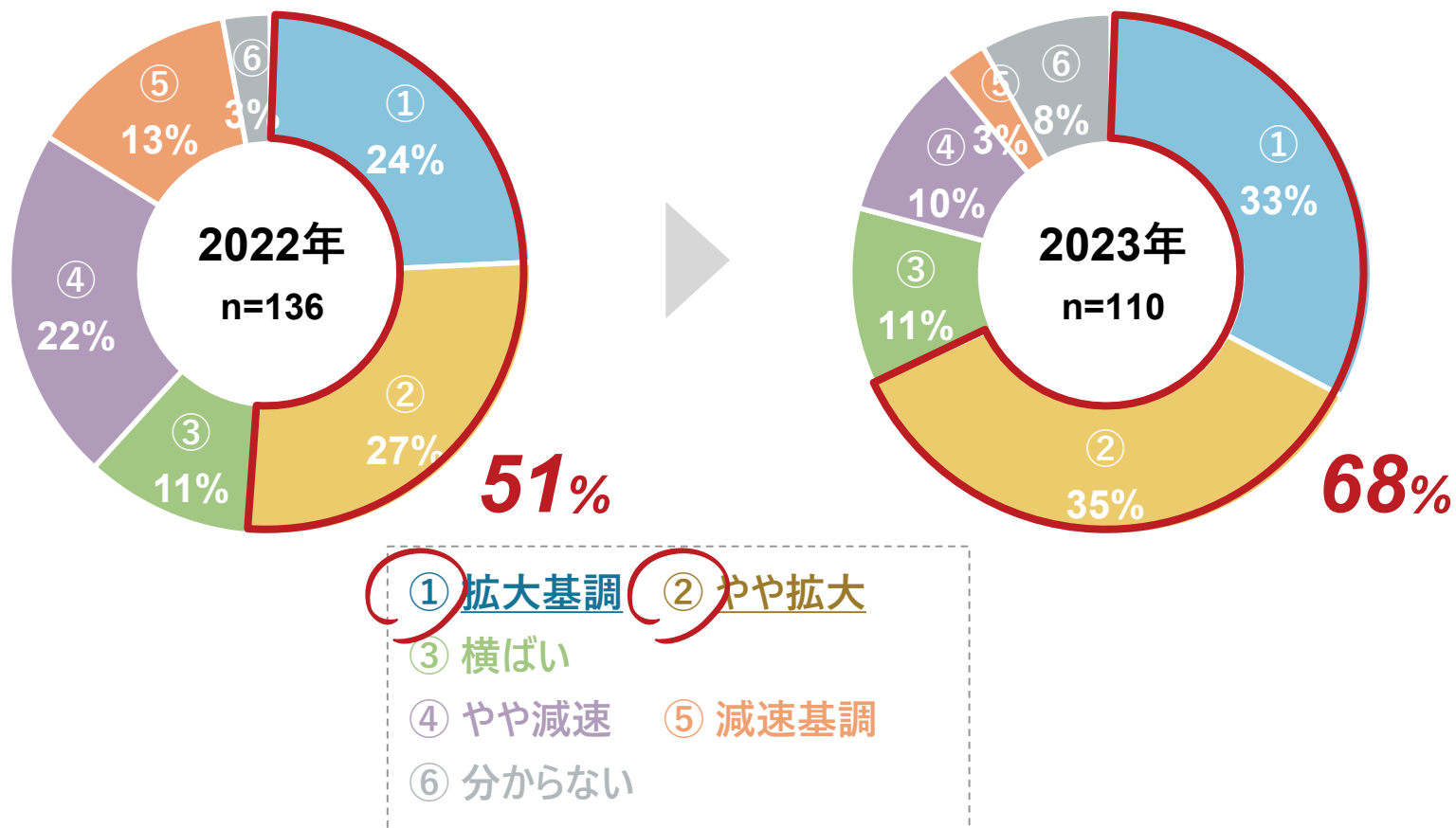


- ① 積極的になった ② 投資検討を始めた
③ 大きな変化はない
④ どちらかと言えば、投資に慎重になった ⑤ 投資検討は中止した
⑥ そもそも投資検討はしていない

台湾半導体見通し

2023年11月22日（水）実施「台日投資カンファレンス（半導体・EV）」アンケート結果

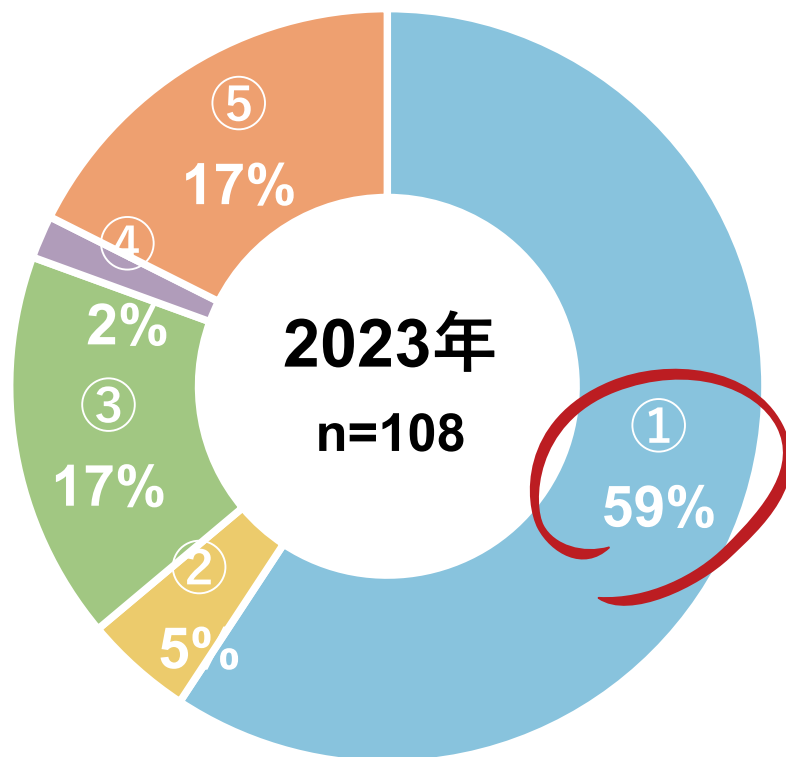
- 「拡大基調」「やや拡大」の合計で、前回比+17%の68%となり、**半導体業界の見通しが明るいとの見方が太宗**
- 2023年は半導体の在庫調整局面の中、2024年以降の先行きに対してポジティブに観ている企業が多いものと推察される



半導体業界において伸張が期待できる領域

2023年11月22日（水）実施「台日投資カンファレンス（半導体・EV）」アンケート結果

- 回答者の多くは、サプライヤーであり、「前工程・後工程ともに伸張する」との回答が59%であり、**半導体製造工程において、これからもビジネスチャンスが十分にあるとの見方**
- 一方、「後工程中心に伸長する」との回答が17%を占め、後工程への期待が前工程よりも高いと考える回答者も多い

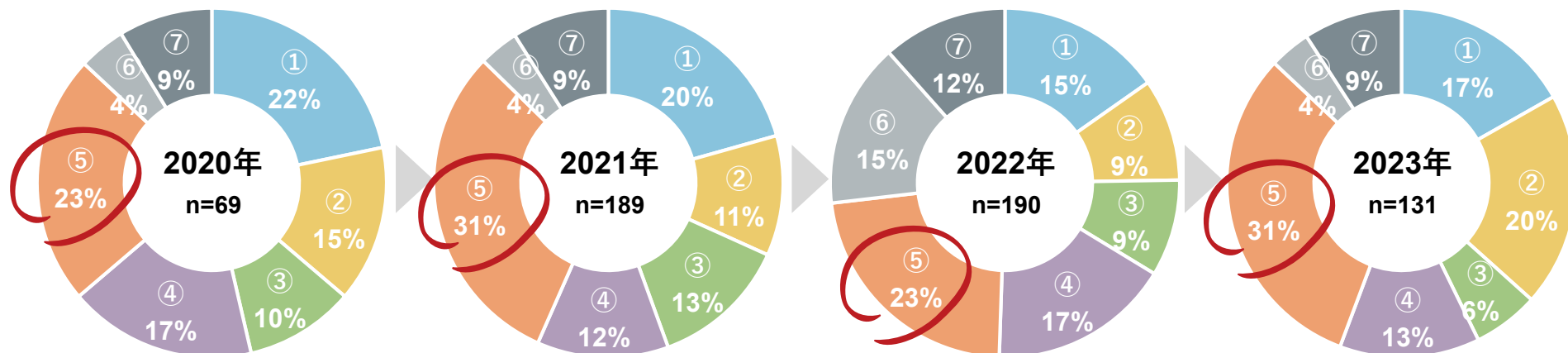


- ① 前工程・後工程ともに伸張する
- ② 前工程中心に伸張する
- ③ 後工程中心に伸張する
- ④ 前工程・後工程ともに更なる伸張は難しい
- ⑤ 分からない

投資実行の際に困った点、あるいは投資を検討される際の懸念事項 (複数回答可)

2023年11月22日（水）実施「台日投資カンファレンス（半導体・EV）」アンケート結果

- 「**従業員の採用**」が過去4回のアンケートで、いずれも回答数が多かった
- 続いて、**政府や地公体からの許認可取得、補助金や税底面等**、経済的な投資優遇策が少ないとの回答が多かった



① 政府や地公体からの許認可取得（建設、消防、環境等）

② 補助金や税制面等、経済的な投資優遇策が少ない

③ 電力・ガス・水道等のインフラ確保

④ 工場建設用地の手当て

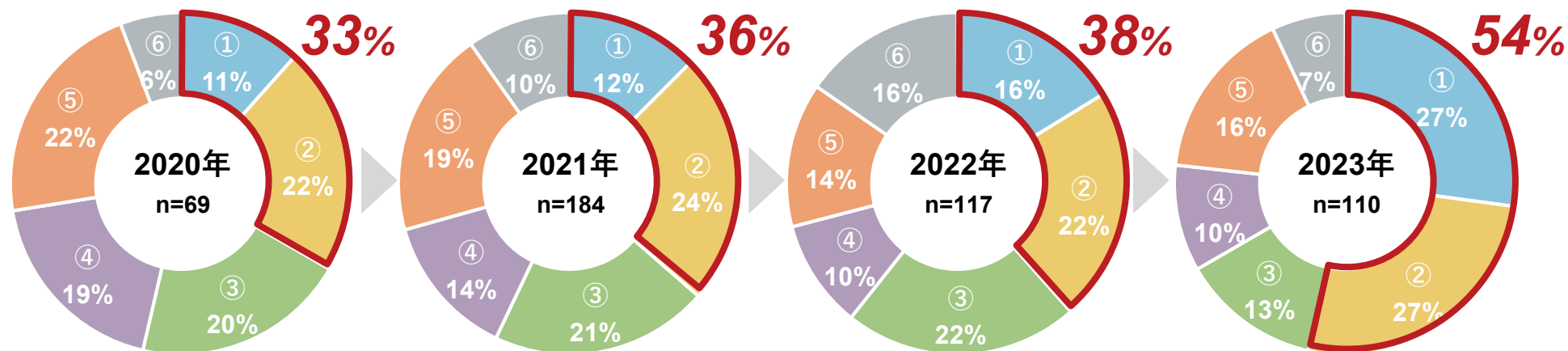
⑤ **従業員の採用**

⑥ 物流網の構築（運送手段の確保、輸送コスト等） ⑦ その他

投資検討にあたっての半導体メーカーとの取引の課題 (複数回答可)

2023年11月22日（水）実施「台日投資カンファレンス（半導体・EV）」アンケート結果

- 回答①、②の比率が、年々増加傾向にあり、今回のアンケートでは54%に
- 特に2022年から2023年にかけての増加は、足元の半導体在庫調整フェーズの中、価格要求が厳しくなっていること、新規工場投資に対してサプライヤーへの情報開示が限定的になっていることが背景と推察



- ① 将来の需要予測や設備投資計画が共有されず、機動的な対応ができない
- ② 価格要求が厳しく（収益性が低く）、投資回収までの期間が長い
- ③ 新設設備ラインと製品の承認に時間がかかる（Fab毎に承認が必要、パイロットラン順番待ち等）
- ④ 増産や在庫積み増しの要請がショートノティス過ぎる、品質管理に要するコスト（分析機器の購入や担当する従業員の人件費）が高い
- ⑤ 品質管理に要するコスト（分析機器の購入や担当する従業員の人件費）が高い、⑥ その他

免責事項

© 2024 株式会社みずほ銀行

1. 法律上、会計上の助言

本資料記載の情報は、法律上、会計上、税務上の助言を含むものではありません。
法律上、会計上、税務上の助言を必要とされる場合は、それぞれの専門家にご相談ください。

2. 秘密保持

本資料記載の情報の貴社への開示は貴社の守秘義務を前提とするものです。
当該情報については貴社内部の利用に限定され、その内容の第三者への開示は禁止されています。

3. 著作権

本資料記載の情報の著作権は当社に帰属します。
いかなる目的であれ本資料の一部または全部について無断で、
いかなる方法においても複製、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行うことを禁止します。

4. 免責

本資料記載の情報は、当社が信頼できると考える各方面から取得しておりますが、その内容の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。実際の取引の実行につきましては、自社自身のご判断で決定してください。
当社は当該情報に起因して発生した損害については、その内容如何に拘わらず一切責任を負いません。